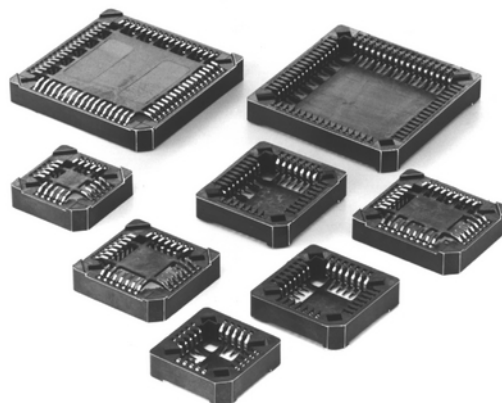


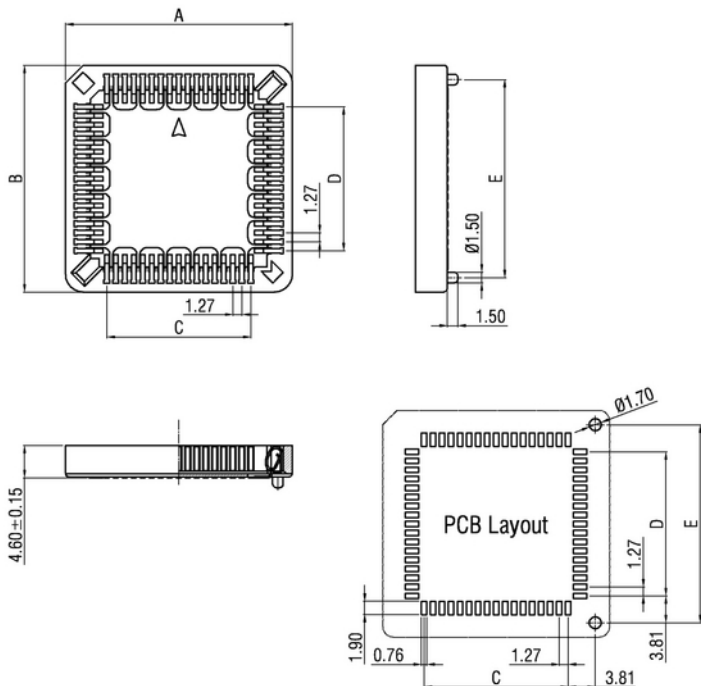
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze <i>Phosphor bronze</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC512-12A
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 10 ⁹ Ω
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{RMS}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +105°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T <i>Reflow-soldering, detailed information in ch. T</i>



© W+P PRODUCTS

Die Chipbestückung kann erst nach dem Lötprozess erfolgen.
We strongly recommend to populate the socket after soldering.



n	A ± 0.25	B ± 0.25	C ± 0.10	D ± 0.10	E ± 0.20
20	15.66	15.66	5.08	5.08	12.70
28	18.20	18.20	7.62	7.62	15.24
32	18.20	20.74	7.62	10.16	17.78
44	23.11	23.11	12.70	12.70	20.32
52	25.83	25.82	15.24	15.24	22.86
68	30.90	30.90	20.32	20.32	27.94
84	35.98	35.98	25.40	25.40	33.02

Series	Contacts*	Plating	Positioning Peg*	Packing*	Colour*
3500	32 20/28/32/44/ 52/68/84	50 50 Verzinkt Tin plated	0 0 Ohne Positionierhilfe W/o locating peg 1 Mit Positionierhilfe With locating peg	ST ST TR	1 1 Schwarz Black 2 Braun Brown

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

Lieferformen / Packing Options:
ST = In Stangen ohne PP-Pad / In tubes w/o PP-Pad
TR = Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel packing

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Information

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{S_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{S_{max}}$) - Zeit ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-180 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{S_{min}}$) - Temperature Max ($T_{S_{max}}$) - Time ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-180 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak-Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:

